

**华润微电子有限公司**  
**投资者关系活动记录表**

(2023年09月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研    <input type="checkbox"/>分析师会议</p> <p><input type="checkbox"/>媒体采访        <input type="checkbox"/>业绩说明会</p> <p><input type="checkbox"/>新闻发布会      <input checked="" type="checkbox"/>路演活动</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</p> <p><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</p>
<p>参与单位名称</p>	<p><b>9月1日 11:00-12:00, 12:00-13:00, 14:30-15:30</b> 广发证券、国信证券、华创证券、长城证券、长鸿资本、荣疆投资、明溪资本、同花顺、新加坡主权基金、国金证券、中财投资、复星财富、安信证券、金鹰基金、大家资产、上海东恺资管</p> <p><b>9月6日 09:00-10:00, 10:30-11:30, 13:30-14:30, 15:00-16:00</b> 开源证券、鹏华基金、摩根大通、普信集团、聚盛全球基金、招商证券、长鸿资本、华林证券、中银国际证券、普赞普资本、韩创资本、臻垚基金、红方资产、朱雀基金、中财招商投资集团、博亚投资、中粮信托、中天资本、上海湘晨投资、海通证券、宜坤私募、富兰克林华美投信、道明资管、兴证全球、汇丰晋信、平安养老、凯石、银河、浙商资管、兴业、南方、中银、中信资管</p> <p><b>9月7日 11:00-12:00, 14:30-15:30</b> 平安证券、国泰基金、国金证券、海富通基金</p>

	<p><b>9月14日 10:00-11:00, 13:00-14:00, 15:00-16:00</b></p> <p>中邮证券、长信基金、中银证券、中航信托、国君资管、太平基金、富安达、浙商资管、开源证券、Point72</p> <p><b>9月22日 08:30-09:30, 10:00-11:00, 15:00-16:00</b></p> <p>浦银国际、平安证券、惠华基金、鸿竹资产、恒松资本、苏州德馨安资管、广东大兴华旗资管、海南果实私募、恒安人寿、国联人寿、平安基金、华贵保险人寿、百联商投、君合资本</p>
时间	<p>9月1日 11:00-12:00, 12:00-13:00, 14:30-15:30</p> <p>9月6日 09:00-10:00, 10:30-11:30, 13:30-14:30, 15:00-16:00</p> <p>9月7日 11:00-12:00, 14:30-15:30</p> <p>9月14日 10:00-11:00, 13:00-14:00, 15:00-16:00</p> <p>9月22日 08:30-09:30, 10:00-11:00, 15:00-16:00</p>
地点	上海、无锡
上市公司接待人员姓名	<p>吴国屹 华润微电子董事、财务总监兼董秘</p> <p>沈筛英 华润微电子投资者关系高级经理</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问题一：请问公司下半年的业绩增长点？</b></p> <p>答：从产能释放角度，公司重庆12吋产线及封装基地产能逐步上量；从市场结构角度，公司积极布局潜力赛道，新能源、汽车电子、工控通信等应用领域占比不断提升；从产品结构角度，IGBT、第三代化合物、传感器、模块等将是未来产品的增长点。</p> <p><b>问题二：请问公司今年的产能扩产情况？</b></p> <p>答：公司6吋晶圆制造生产线主要增加第三代半导体的产能；8吋晶圆制造生产线通过技改会带来一定幅度的产能增加；重庆12吋2023年底规划产能爬坡至2万片。</p>

**问题三：请问公司下半年产品的价格趋势？**

答：不同产品、不同细分市场和应用领域价格表现有所差异。

**问题四：请问公司下半年代工的价格趋势？**

答：部分工艺平台会面临价格的压力。

**问题五：请问公司目前封测的产能及后期规划？**

答：公司目前封装能力月产能 8.7 亿颗，未来公司将通过重庆封测基地项目为抓手，全面覆盖功率半导体产品模块封装、晶圆中道生产线、面板级封装、第三代半导体封装等技术领先门类，有序推进封装工艺升级。

**问题六：请问公司封测基地目前进展？**

答：公司功率封测基地已于去年年底通线，目前正在上量。

**问题七：请问公司 IDM 业务终端应用结构占比情况？**

答：公司 IDM 业务终端应用主要分为 8 大类，其中新能源占比 20%，车类占比 19%，工业设备占比 17%，家电占比 16%，通信设备占比 12%，计算机占比 5%，照明占比 5%，智能穿戴、医疗及其他占比 6%。公司整体泛新能源领域（车类及新能源）占比已经达到了 39%。

**问题八：请问公司 6 吋、8 吋、12 吋产能内部自用和外部客户代工是如何分配的？**

答：6 吋产线自用和外部客户代工比例为 6:4；无锡 8 吋产线 80%左右用于外部客户代工，重庆 8 吋产线全部自用；重庆 12 吋产线将全部用于自有产品。

**问题九：请问公司功率 IC 主要有哪些产品？**

答：公司功率 IC 主要包括 LED 驱动、电源、电机驱动、功放电路、BMS、AC-DC、DC-DC、无线充等产品。

**问题十：请问公司在光伏市场的布局？**

答：公司 MOSFET、IGBT、SBD、TMBS 模块均已进入光伏应用，公司自有产品下游应用结构中新能源(含光伏)占比达到 19%，

产品导入光伏组件龙头客户并实现批量供货。

**问题十一：请问功率半导体行业未来是否会出现供过于求的情况？**

答：公司认为功率半导体未来仍有较大发展空间。全球功率半导体行业需求具有巨大的增量潜力，其中风光车储的应用为新兴应用，增长空间较大；国内高端功率产品的市场仍有较大的替代空间。

**问题十二：请问公司模块产品的进展？**

答：公司模块产品包括 TMBS 模块、IPM 模块、IGBT 模块、MOS 模块，2023 年将会实现较快增长。其中：TMBS 模块上半年销售大幅增长，同比增幅超 5.5 倍；IGBT 模块完成电焊机、变频器、光伏、新能源汽车电驱等 4 个应用领域多个型号的模块产品开发；IPM 模块重点平台建设持续取得重大突破并大力发展全集成产品，上半年销售额同比增长 208%，并进入车用电子市场供应链。

**问题十三：请问公司碳化硅的产品结构及进展情况？**

答：公司碳化硅 MOS 产品在碳化硅功率器件销售中的比例提升至 50%以上，在新能源汽车、光伏储能、工业电源等领域多个客户规模上量。

**问题十四：请问公司氮化镓产品的进展情况？**

答：公司氮化镓产品应用以 PC 电源、电机驱动、照明电源、手机快充为主，在通讯、工控、照明和快充等领域实现多家行业头部客户合作，产品进入批量供应阶段，上半年营收实现快速增长，同期增加 192%。

**问题十五：请问公司 MCU 主要应用及价格展望？**

答：公司 MCU 产品主要以工控、消费应用为主，同时公司安全 MCU 产品主要应用物联网、工业互联网、汽车电子等智能终端，目前已顺利完成芯片的质量考核，已通过重点客户的应用验

	<p>证，准备批量供货。</p> <p><b>问题十六：请问公司 MOS 产品结构是什么？</b></p> <p>答：在公司 MOSFET 产品中，中低压产品占比 63%，高压产品占比 37%，先进低压沟槽 MOS 及高压超结 MOS 在营收中的占比超过 60%。</p> <p><b>问题十七：请问公司掩模业务进展及应用领域？</b></p> <p>答：公司上半年掩模业务销售额同比实现一定幅度增长，产能目前 3000 片/月，掩模业务已服务国内各主要 FAB 线及众多 IC 设计公司。高端掩模项目已在建设中，规划产能 1000 片/月，预计在 2024 年可提供 40nm 及以上线宽的掩模代工服务。</p> <p><b>问题十八：请问公司投资并购的主要方向？</b></p> <p>答：公司以产品公司为主要方向，围绕功率半导体、传感器、智能控制三大领域寻找合适的投资标的，以此丰富公司产品系列、补齐公司产品链。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 09 月